2026年10月23日

各　位

会 社 名　株式会社岡本工作機械製作所
代 表 者　代表取締役社長執行役員　　伊藤　暁
（コード番号6125　　東証　スタンダード市場）
問合せ先　取締役常務執行役員
管理本部長　　高橋 正弥
（TEL.027－385－5800）

第三者割当増資における調達資金の資金使途および支出予定時期の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、2024年５月22日付「資本業務提携、第三者割当による新株式の発行並びに主要株主である筆頭株主及びその他の関係会社の異動に関するお知らせ」並びに2026年６月12日付、６月26日付及び７月31日付「第三者割当増資における調達資金の資金使途および支出予定時期の一部変更に関するお知らせ」において開示いたしました第三者割当増資（以下「第三者割当」という。）に係る調達資金の資金使途及び支出予定時期について、一部変更することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1.　変更の理由

当社は、2026年７月31日付「第三者割当増資における調達資金の資金使途および支出予定時期の一部変更に関するお知らせ」において、第三者割当により調達した資金のうち、下記⑥-3「今後の事業環境や当社グループの成長戦略を踏まえた資金活用（詳細未定）」として3,019百万円を計上し、具体的な資金使途及び支出予定時期については未定である旨を開示しておりました。

当社は、中長期戦略「ビジョン2030」及び中期経営計画「INOFINITY700」において、半導体関連装置事業を積極投資セグメントと位置付け、次世代分野における新機種開発及び事業拡大を推進しております。

半導体市場においては、生成AIをはじめとする先端半導体分野の成長に伴い、半導体の高性能化・高集積化に対応する先端パッケージング技術の重要性が高まっております。こうした中、当社では、PLP（Panel Level Packaging）を次世代分野の一つと位置付け、加工装置の開発を進めております。

今般、今後の事業環境及び当社グループの成長戦略について検討を進めた結果、PLP 市場への対応力をさらに強化し、半導体関連装置事業の中長期的な成長につなげるため、下記⑥-3に係る資金をPLP向け大型加工装置の研究開発投資に充当することとし、当該資金使途に係る金額及び支出予定時期を決定いたしました。

当該研究開発においては、当社がこれまで培ってきた砥粒加工技術及び半導体関連装置分野における技術・ノウハウを活用し、PLP で使用される大型基板に対応した加工装置の開発を進めることで、製品ラインアップの拡充及び半導体関連装置事業の競争力強化を図ってまいります。

また、当該装置の開発を通じて、台湾を中心とする東アジア圏における半導体関連顧客への提案活動を強化するとともに、国内市場においても新たな顧客層への展開を進め、国内外における新規顧客の獲得及び顧客基盤の拡大につなげてまいります。

なお、上記研究開発投資への充当後の残額につきましては、引き続き今後の事業環境や当社グループの成長戦略を踏まえた資金活用について検討を継続しており、現時点において具体的な資金使途及び支出予定時期は未定であります。

今後、具体的な内容が決定した場合には、速やかに開示いたします。

2.　変更の内容

当社は、2026年７月31日付「第三者割当増資における調達資金の資金使途および支出予定時期の一部変更に関するお知らせ」において、第三者割当により調達した資金の資金使途、金額および支出予定時期の一部変更を開示しており、その時点において下記⑥-3に係る具体的な資金使途及び支出予定時期については未定としておりました。

今般、下記⑥-3に係る資金の一部について具体的な資金使途、金額及び支出予定時期を決定したことに伴い、前回開示時点の内容から下記のとおり変更いたします。（なお、変更箇所は下線で示しております。）

（前回開示時点）

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
①　半導体関連装置及び工作機械に関連した技術開発棟の新設、ショールームの刷新のための設備資金	1,731	2024年８月～2027年３月
②　次世代機種の新規開発に向けた研究開発投資	1,500	2024年８月～2026年３月 （充当済）
③　半導体関連装置及び工作機械に関連した高い付加価値を継続的に提供するための自動倉庫棟の建設資金	1,606	2024年６月～2026年２月 （充当済）
④　大和工機株式会社における半導体関連装置の生産能力向上に向けた設備更新・新規設備投資	－	－
⑤　①の技術開発棟のラボ機能の向上および人財戦略の拠点としての活用のための設備資金および改修工事等資金	800	2026年７月～2028年３月
⑥-1　台湾におけるデモ施設設立	550	2026年８月～2029年12月
⑥-2　半導体関連装置における次世代半導体材料向け新規加工装置の研究開発投資	400	2026年８月～2029年12月
⑥-3　今後の事業環境や当社グループの成長戦略を踏まえた資金活用（詳細未定）	3,019	未定

（今回変更後）

具体的な使途	金額（百万円）	支出予定時期
①　半導体関連装置及び工作機械に関連した技術開発棟の新設、ショールームの刷新のための設備資金	1,731	2024年８月～2027年３月
②　次世代機種の新規開発に向けた研究開発投資	1,500	2024年８月～2026年３月 （充当済）
③　半導体関連装置及び工作機械に関連した高い付加価値を継続的に提供するための自動倉庫棟の建設資金	1,606	2024年６月～2026年２月 （充当済）
④　大和工機株式会社における半導体関連装置の生産能力向上に向けた設備更新・新規設備投資	－	－
⑤　①の技術開発棟のラボ機能の向上および人財戦略の拠点としての活用のための設備資金および改修工事等資金	800	2026年７月～2028年３月
⑥-1 台湾におけるデモ施設設立	550	2026年８月～2029年12月
⑥-2 半導体関連装置における次世代半導体材料向け新規加工装置の研究開発投資	400	2026年８月～2029年12月
⑥-3　PLP向け大型加工装置の研究開発投資	1,066	2026年10月～2030年９月
⑥-4 今後の事業環境や当社グループの成長戦略を踏まえた資金活用（詳細未定）	1,953	未定

（注）調達資金が充当されるまでの間は、現金又は現金同等物にて管理します。

3.　業績への影響

資金使途の金額および支出予定時期の変更による当期業績への影響は軽微であると見込んでおりますが、開示の必要性が生じた場合には速やかにお知らせいたします。

以　上